

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：芯碁微装

股票代码：688630

编号：2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	安徽上市公司协会、国泰君安证券、农银汇理基金、华安基金、西部利得基金、人保资产、圆信永丰基金、泉果基金、北京宏道投资、上海陶山私募基金。
时间	9月10日下午
地点	芯碁微装产业园内
公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：魏永珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、主要交流问题如下：</p> <p>1、今年PCB设备需求是怎样的？</p> <p>答：PCB设备主要有两种需求，包括新产线建设需求和原有产线升级迭代需求。东南亚周边，特别是泰国区域PCB企业批量建厂新增设备需求较好，预计约在全年PCB订单三成以上。境内设备订单中迭代升级的需求较以往年度增加。</p> <p>2、PCB头部客户稼动率怎么样</p> <p>答：从今年二季度开始，PCB头部客户稼动率在80-90%以上。</p> <p>3、PCB产线升级改造需要升级哪些装备？</p> <p>答：PCB原有产线升级，涉及到的曝光、刻蚀、显影、钻孔、检测设备均需要配套升级，其中曝光设备包括内外层线路及阻焊层设备的升级，在设备支出中占比较高。</p> <p>4、二期园区产能提升情况如何？</p>

答：公司二期园区产能约为一期的 2-3 倍，二期园区预计今年年底完成基建工程，接下来将尽快完成园区装修并投产，整体建设节奏紧凑，预计于明年年中释放产能。

5、新品键合设备的单价和进展如何？

答：公司键合设备能够实现热压键合，目前支持的最大晶圆尺寸为 8 英寸，采用半自动化操作，可运用于先进封装、MEMS 等多种场景用，今年下半年将有设备出货，设备单价预计在数百万级别。

6、在先进封装领域公司后续是否会推出更精细的产品？

答：公司晶圆级封装设备 WLP2000 精度可达 $2\mu\text{m}$ ，技术较成熟，关注度高，目前已客户端做量产测试。同时，公司也在研制更高端、精细度更高的晶圆级封装设备，产品定价上相较于 WLP2000 系列会有所提升，待设备推出后公司会相较竞品择取更有竞争性的价格区间，让设备产品更具质价比。

7、今年海外订单情况如何？

答：2023 年海外订单占比不高，今年公司加大了东南亚地区的市场布局，目前进展不错，海外订单较去年会有较大的增幅，其中沪电股份、定颖电子、希门凯电子等订单表现亮眼。目前全球 PCB 厂商纷纷赴东南亚建厂，同时叠加 PCB 技术升级，高端 HDI、SLP、载板、ABF 载板等成为厂商的主要扩产方向，直写光刻在精细化线路方向上成为最佳方案，行业资本开支有望带动公司业绩持续向上。

8、海外订单交付周期如何？

答：海外 PCB 量产机型订单制造周期在 2-3 周左右。

9、二期募集资金的投向情况如何？

答：公司定增募投资金主要用于扩大 PCB 阻焊、IC

	<p>载板、类载板产能，并拓展新型显示、引线框架、新能源光伏直写光刻设备业务。随着 AIGC 的高速发展，PCB 产品结构不断升级，公司 PCB 中高阶产品目前进展较好，类载板、HDI 订单表现优秀。今年公司加大了对高端阻焊市场的 NEX 系列设备的扩产，凭借设备优异的曝光精度及良率不断提升国产化替代速度。泛半导体方面，今年加快了在先进封装、新型显示、功率分立器件等方面的布局，与各个细分领域头部客户进行战略合作，与下游共同成长。</p> <p>10、显示业务今年的进展情况？</p> <p>答：新型显示方面，公司设备在解决 Mini/micro-LED 的芯片、基板制造及利用 RDL 再布线技术解决巨量转移问题均有较好的优势，已开拓维信诺、辰显光电、沃格光电等优质客户，今年公司积极切入头部客户京东方供应链，目前屏幕传感器 RTR 设备已发货至京东方，LCD 制程曝光打码量产设备也即将出货。获得头部客户的订单将为公司注入强大增长动力，为公司后续业务的持续拓展奠定了坚实的基础。</p> <p>11、今年 PCB 订单情况如何？</p> <p>答：PCB 方面，公司部署了大客户战略及海外战略。大客户战略方面的订单需求，会为公司带来一定的增量支撑，海外策略作为近两年公司最重要的战略之一。今年二季度以来，PCB 行业稼动率较第一季度有所提升，公司生产端从四月份开始已达满产状态。下游客户今年对高阶板的需求增速较快，高阶头部客户的订单需求趋势较为确定，叠加下游客户在东南亚产能的转移，海外订单增长趋势明显。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-9-10